



## NXP stellt den ersten sicheren Tri-Radio-Chip der Branche vor

- Die branchenweit erste monolithische Tri-Radio-Chip Familie unterstützt Wi-Fi 6, Bluetooth® 5.2 und IEEE 802.15.4 und ermöglicht durch gleichzeitiges Senden und Empfangen der unterschiedlichen Technologien einen höheren Durchsatz in intelligenten IoT-Lösungen
- Die Lösung unterstützt *matter*, den interoperablen, sicheren Verbindungsstandard für die Zukunft des Smart Home, der eine beispiellose Koexistenz, Leistung und Funkintegration bietet
- Der Tri-Radio-Chip verbindet nahtlos intelligente Geräte über Protokolle und Ökosysteme hinweg, vereinfacht die Entwicklung und reduziert Kosten und Platzbedarf für intelligente Smart Home-, Automobil- und Industriegeräte

**LAS VEGAS, 5. Januar 2022** – NXP® Semiconductors (NASDAQ: NXPI) stellt den Chip IW612 vor, der branchenweit erste sichere Tri-Radio-Chip, welcher die Protokolle WiFi-6, Bluetooth 5.2 und IEEE 802.15.4 unterstützt. Als Teil der neuen Familie von Tri-Radio-Produkten von NXP ermöglicht der Chip nahtlose und sichere Konnektivität für Smart-Home-, Automobil- und Industrieanwendungen und unterstützt den neuen *matter*-Verbindungsstandard. Mit dem IW612 sind Anwender\*innen nicht mehr an ein einzelnes Protokoll-Ökosystem gebunden, da ihnen das Gerät eine nahtlose Interoperabilität über verschiedene Ökosysteme und drahtlose Netztechnologien hinweg ermöglicht. Darüber hinaus profitieren Entwickler\*innen von der neuartigen integrierten Lösung von NXP, welche den gleichzeitigen Betrieb von drei Funktechnologien auf einem einzigen Produkt ermöglicht und so Kosten und Entwicklungszeiten reduziert.

Eine der größten Herausforderungen im IoT-Bereich ist die begrenzte Interoperabilität, die Anwender\*innen daran hindern kann, Smart-Home-Produkte verschiedener Unternehmen miteinander zu kombinieren. *matter* ist ein neues standardisiertes Verbindungsprotokoll für IoT-Geräte, das von einem Konsortium aus Branchenführern, darunter NXP, entwickelt wurde. *matter* hebt diese Einschränkungen auf, indem der Standard die Kommunikation von Geräten unabhängig vom Hersteller oder von der Funktechnologie vereinheitlicht. Das Protokoll schafft mehr Verbindungen zwischen mehr Objekten und vereinfacht so die Entwicklung für die Hersteller und die Kompatibilität für die Anwender\*innen.

Um diese neue Generation der Interoperabilität zu unterstützen, integriert der Chip IW612 zum ersten Mal drei der branchenführenden drahtlosen Verbindungsstandards in ein einziges Produkt, das damit eine hoch robuste Funkleistung in einem hochleistungsfähigem HF-Frontend bietet. Diese Technologiekombination ermöglicht eine echte Interoperabilität im Smart Home, was Entwicklungszeiten erheblich verkürzt, das Design vereinfacht und die Kosten senkt. Die hochintegrierte Lösung bewältigt die Herausforderungen der Hardware-Koexistenz, mit denen Entwickler\*innen heute konfrontiert sind, und ermöglicht gleichzeitig fortschrittliche Sicherheitsprotokolle, die dazu beitragen, die ständig wachsenden Sicherheitsbedrohungen im IoT abzuwehren.

Der Chip IW612 profitiert bei der Bewältigung ständiger Sicherheitsbedrohungen für intelligente Geräte von der langjährigen Erfahrung von NXP als führendem Anbieter von sicheren Lösungen. IW612 bietet sicheres Booten, Debugging und Over-the-Air-Firmware-Updates für kontinuierlichen Schutz sowie WPA3-Sicherheit mit Hardware basierenden Verschlüsselungsmodulen.

„Mit dem IW612 können Entwickler\*innen verschiedene drahtlose Verbindungsprotokolle auf einem einzigen Gerät nutzen, um ein einfach zu bedienendes, sicheres Produkt für Smart Home-, Industrie- und Automobilanwendungen zu schaffen“, so Larry Olivas, Vice President und General Manager für Wireless Connectivity Solutions, NXP Semiconductors. „Von Türschlössern und intelligenten Lautsprechern bis hin zur Fahrzeugunterhaltung und Telematik können Produkte jetzt von unseren Tri-Radio-Lösungen profitieren, da sie mehrere Technologien und Ökosysteme unterstützen, einschließlich *matter*. Dies bietet Entwickler\*innen eine kostengünstigere Lösung und vereinfacht gleichzeitig die Nutzung für die Anwender\*innen.“



„Interoperabilität ist seit Jahren eine der größten Herausforderungen, die den Smart-Home-Markt fragmentiert hat, aber *matter*-fähige Geräte können das jetzt ändern“, sagt Jonathan Collins, Research Director bei ABI Research. „Mit den neuen monolithischen Tri-Radio-Chips ermöglicht es NXP den Entwickler\*innen, die von *matter* unterstützten drahtlosen Verbindungsprotokolle für ihre Smart-Home-Anwendungen zu nutzen und so die Verbreitung von *matter* zu beschleunigen. Dies wiederum wird den Anwender\*innen eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit bieten, da sich smarte Geräte einfacher verbinden lassen und sie eine größere Auswahl an interoperablen Geräten haben, die sie verwenden können.“

#### **Weitere Details:**

Der IW612 Chip ist eine ideale Lösung für Border-Router, Bridges und Gateways im Smart Home, die Thread- oder Bluetooth-Geräte über das integrierte Wi-Fi 6-Funkmodul mit der Cloud verbinden müssen. Darüber hinaus ermöglicht der IW612 Chip die Kommunikation zwischen Matter-Geräten, unabhängig davon, ob die Geräte Wi-Fi oder Thread verwenden. So können Matter-over-Wi-Fi-Produkte Matter-over-Thread-Geräte steuern und überwachen und umgekehrt, was eine nahtlose Interoperabilität ermöglicht.

#### **Die wichtigsten Eigenschaften des IW612 sind:**

- Tri-Radio-Integration
  - Wi-Fi 6 verringert die Überlastung des Netzwerks, vergrößert die Reichweite und verbessert die Robustheit und senkt den Stromverbrauch.
  - Bluetooth 5.2 für Audio (A2DP, LE Audio), Sprache und Netzwerk-Inbetriebnahme
  - 802.15.4 für Matter mit Thread Mesh Networking
- Fortschrittliche Koexistenz für den internen und externen Multi-Funk-Betrieb
- Robuste Sicherheit zum Schutz vor IoT-Angriffen
- Validierte Anbindung an das breite Mikroprozessor- und Mikrocontroller-Portfolio von NXP
- Integriertes HF-Frontend mit LNAs, Hochleistungs-PAs und Schaltern zur Systemkosteneinsparung und geringere externe Anzahl von Bauelementen für einen verringerten Flächenbedarf.

#### **Produktverfügbarkeit**

[IW612](#) Chip Muster sind ab sofort erhältlich und das Produkt wird auf der CES 2022 live vorgeführt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [NXP.com/Matter](https://www.nxp.com/Matter) oder kontaktieren Sie den globalen NXP-Vertrieb.

#### **Über NXP Semiconductors**

NXP Semiconductors N.V. ermöglicht sichere Verbindungen für eine intelligentere Welt und wartet mit Lösungen auf, die unser Leben einfacher, besser und sicherer machen. Als weltweiter Marktführer bei Lösungen für die sichere Kommunikation in Embedded-Applikationen treibt NXP Innovationen in den Anwendungsfeldern Automobiltechnik, Industrie & IoT, bei Mobilgeräten und Kommunikationsinfrastruktur voran. Das Unternehmen, welches auf eine geballte Erfahrung und Expertise von mehr als 60 Jahren bauen kann, beschäftigt ca. 29.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern und konnte 2020 einen Umsatz von US\$8,61 Milliarden verbuchen. Weitere Details unter: [www.nxp.com](https://www.nxp.com)

NXP und das NXP-Logo sind eingetragene Warenzeichen von NXP B.V. Alle anderen Produkt- und Servicebezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Alle Rechte vorbehalten. © 2021 NXP B.V.

#### **Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte:**

##### **Amerika & Europa**

Phoebe Francis

Tel: +1 737-274-8177

E-mail: [phoebe.francis@nxp.com](mailto:phoebe.francis@nxp.com)

##### **China/Asien**

Ming Yue

Tel: +86 21 2205 2690

E-mail: [ming.yue@nxp.com](mailto:ming.yue@nxp.com)